

1 TED プログラマブル ソリューション 2013 開催

FPGA最先端テクノロジーとソリューションを紹介するイベントを開催。

TED プログラマブル ソリューション 2013

日程：2013年2月1日
会場：東京コンファレンスセンター品川
主催：東京エレクトロン デバイス株式会社 PLD事業部
後援：ザイリンクス社

基調講演、メーカ講演、セミナー、ザイリンクス社最新ソリューションやパートナー企業、当社取り扱いのFPGA関連商品を展示。



TPS2013 講演会

2 レスキューロボットコンテスト特別協賛

「技術を学び 人と語り 災害に強い世の中をつくる」というレスキューロボットコンテストの理念に賛同し、CSR(企業の社会的責任)の一環として、特別協賛をしております。

第13回レスキューロボットコンテスト

競技会本選：2013年8月10日～11日
会場：神戸サンボーホール

第13回は神戸と東京の二会場で予選を開催。
前回より6チーム増え、26チームが参加予定。
(<http://www.rescue-robot-contest.org>)



第12回コンテスト競技本選

3 個人投資家様向けIR活動

個人投資家様向けのIRフェアや会社説明会に参加しております。

また、当社ホームページ内に個人投資家様向け専用サイトをご用意し、事業内容、業績情報等の配信に努めております。

(<http://www.teldevice.co.jp/ir>)



日経IRフェア2012 ミニプレゼン

将来の業績見通しに関する注意事項

このインベスターズガイドは、2013年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想などの将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性など、一切保証しませんので御了承下さい。最新情報については、公表資料または当社Webサイトを御参照下さい。

お問い合わせ先

TELTM 東京エレクトロン デバイス株式会社
広報・IR室 E-mail: ir-info@teldevice.co.jp

本社：〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア
Tel.045-443-4000 (代表) Fax.045-443-4050



適切に管理された森林からの原料を含むFSC®認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用しています。



投資家の皆様へ

インベスターズガイド INVESTORS GUIDE 2013



東京エレクトロン デバイス

東京エレクトロンデバイスは、半導体とIT機器の専門商社です。

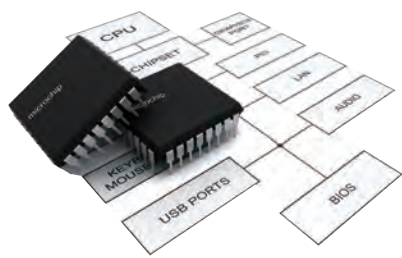
仕 入

当 社

販 売

半導体及び電子デバイス事業

半導体、電子部品、ソフトウェアを
電子機器メーカーなどに販売



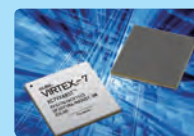
海外の有力メーカーの 最先端半導体



TI社製品



リニアテクノロジー社製品



ザイリンクス社製品

技術サポートに強み



幅広い最終製品に採用



コンピュータシステム関連事業

ストレージやネットワークなどのIT機器を
官公庁やネットワーク構築会社などに販売



北米IT機器メーカーの 新規性・専門性の高い商品



F5ネットワーク社製品



プロケード社製品



EMC社(グリーンブラム)製品

保守サポートに強み



インターネットなどの 最適なIT環境を提供



INDEX

株主・投資家の皆様へ

業績報告と見通し	3
3ヶ年計画／株主還元	4

事業紹介

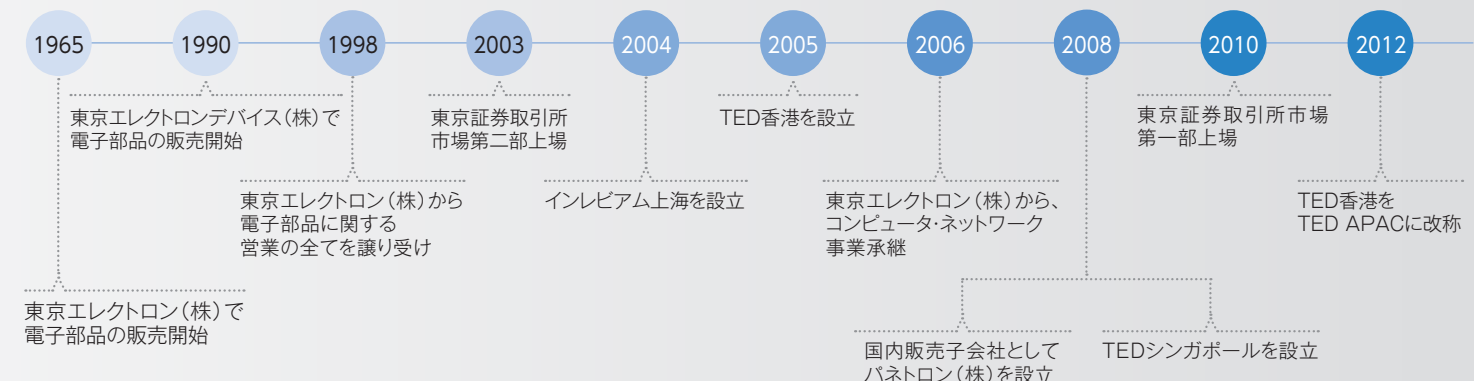
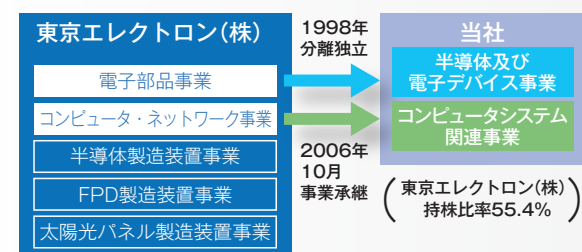
半導体及び電子デバイス事業	5
コンピュータシステム関連事業	9

財務データ等

マーケット情報	11
連結経営指標	12
連結財務諸表	15
会社概要／株式情報	17

ヒストリー

当社は、東京エレクトロン株式会社から分離・独立した
技術商社です。約半世紀の歴史と実績を誇ります。



株主・投資家の皆様へ

投資家の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別なご支援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

当社は、長い歴史の中で培ってきた経験と技術力を生かし、付加価値の高い商品を提供する技術商社として活動してまいりました。今後も既存事業の一層の発展と新分野への挑戦を活動方針に、さらなる企業価値向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
栗木 康幸

代表取締役副社長
久我 宣之

2013年3月期の業績報告

2013年3月期におけるわが国経済は、日銀の金融緩和強化に対する期待感に加え、アメリカの経済指標に改善が見られたことなどを背景として、円高の是正や株価の上昇など期末にかけて明るい兆しが見え始めておりますが、依然として欧州債務危機の再燃やアメリカの財政緊縮など景気の先行きに対する懸念材料が残る状況となっております。

当社グループが参画しているエレクトロニクス業界においては、世界の半導体需要がアメリカやアジア地域を中心として回復基調にある中、日本ではテレビ等の民生用電子機器や産業機器等の需要が低迷しております。IT産業においては、データセンターやクラウドコンピューティング市場が拡大基調にあるものの、製造業を中心とした民間設備投資は厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、2013年3月期の売上高は854億7千7百万円(前期比1.0%減)、営業利益は17億9千万円(前期比11.0%減)、経常利益は当期に為替差損を計上したことなどにより、12億9千2百万円(前期比44.6%減)、当期純利益は6億5千8百万円(前期比31.5%減)となりました。

2014年3月期の見通し

円高是正や株価上昇など景気回復の兆しがあるものの、依然としてエレクトロニクス業界は厳しい状況が続いております。当社グループにおける半導体及び電子デバイス事業では、既存ビジネスや商権獲得による販路拡大に留まらず、海外展開や新規プロダクトの投入に注力してまいります。また、コンピュータシステム関連事業では、直接販売体制の強化だけでなく、新規プロダクトを積極的に取り入れることで、顧客への高付加価値製品やソリューションの提供に邁進してまいります。

このような状況を踏まえ、2014年3月期の通期連結業績見通しについては、売上高900億円(前期比5.3%増)、経常利益15億円(前期比16.0%増)、当期純利益9億3千万円(前期比41.2%増)を見込んでおります。

2014年3月期連結業績予想

	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)
中間期	42,500 (△ 0.9%)	450 (△ 34.4%)	280 (△ 31.1%)
通 期	90,000 (5.3%)	1,500 (16.0%)	930 (41.2%)

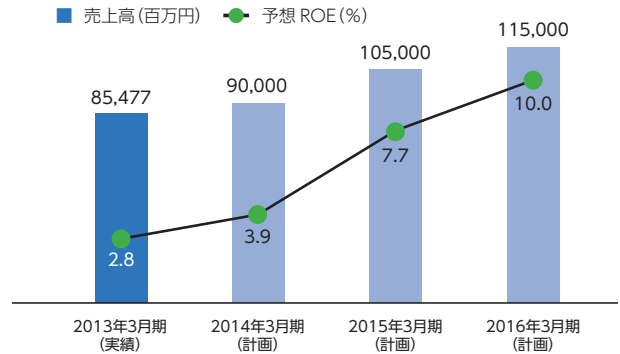
(注) %表示は前年同期増減率

3ヶ年計画

当社グループの「3ヶ年計画」は、ローリング方式を採用しております。これまでの業績推移や事業環境の変化等を勘案した上、その内容について見直しを行い、2013年4月26日に新たな3ヶ年計画を発表いたしました。

	2013年3月期 (実績)	2014年3月期 (計画)	2015年3月期 (計画)	2016年3月期 (計画)
売上高(百万円)	85,477	90,000	105,000	115,000
経常利益(百万円)	1,292 (1.5%)	1,500 (1.7%)	3,000 (2.9%)	4,000 (3.5%)
当期純利益(百万円)	658 (0.8%)	930 (1.0%)	1,890 (1.8%)	2,600 (2.3%)
予想ROE (%)	2.8	3.9	7.7	10.0

(注) カッコ内は利益率



半導体及び電子デバイス事業の強化

半導体産業が構造的な変化を続ける中、事業環境へ柔軟に対応する組織構造の改善・整備を行い、仕入先・顧客の双方からより一層信頼されるきめ細やかな対応を図ってまいります。また、国内外において新商材の開拓を継続することで、顧客の課題解決に貢献してまいります。

技術提案を含む受託設計製造ビジネス、自社開発の製品事業である「inrevium(インレビウム)」についてはアジアを中心に海外拠点との連携を深め、日系企業向けだけではなく現地企業に根付く販売促進活動に注力いたします。

コンピュータシステム関連事業の強化

今後、クラウドコンピューティング市場の更なる進展に伴うデータセンターの拡大に対応するため、従来のシステム構築・導入支援・保守サポートサービスに留まらず、これまでに獲得した新たな商材を生かし、顧客に最適なIT環境の提案を推進してまいります。

新規事業への進出

既存の商材に加え、環境・省エネルギー分野の新たな商品ラインアップの拡充を継続してまいります。

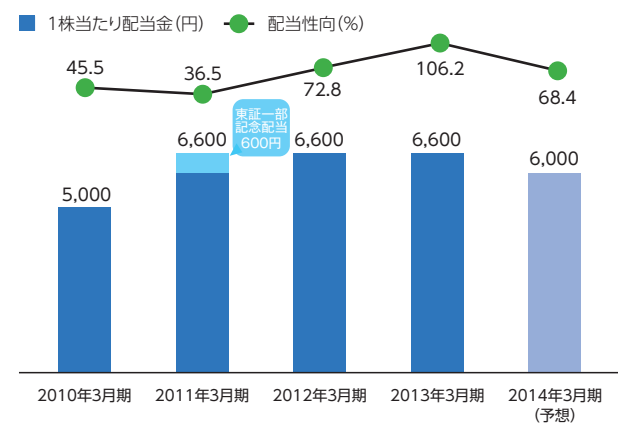
株主還元について

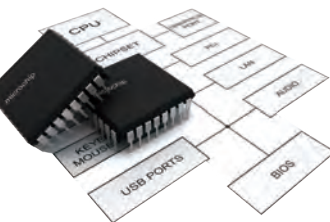
当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、継続的かつ安定的な配当実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則としております。

当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安といたします。

2013年3月期の配当につきましては、この基本方針をふまえ、期末配当を3,300円、中間配当と合わせた年間配当を1株につき6,600円とさせていただきます。

2014年3月期の配当につきましては、1株当たり6,000円(中間3,000円・期末3,000円)を予定しております。





事業紹介

半導体及び電子デバイス事業

2013年3月期の業績

半導体製品等の国内需要が民生用電子機器・産業機器ともに低水準で推移したことにより、前期と比べた国内販売実績は概ね10％程度の減少となりました。一方、中国及びアジア地域では商権の拡大によって海外事業が伸びました。これらの結果、売上高は706億4千1百万円（前期比1.6％減）、セグメント利益（経常利益）は商権拡大に伴う人員増及びのれん償却額等の経費負担により、1億5千4百万円（前期比82.8％減）となりました。

2014年3月期の見通しと活動方針

業績見込：売上高750億円（前期比6.2％増）

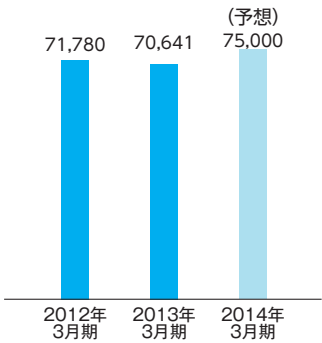
活動方針：国内外における新商材の開拓継続と既存商材の深堀り

海外ビジネスの拡大

自社ブランド「inrevium（インレビウム）」の販売を促進

半導体及び電子デバイス事業

■売上高（百万円）

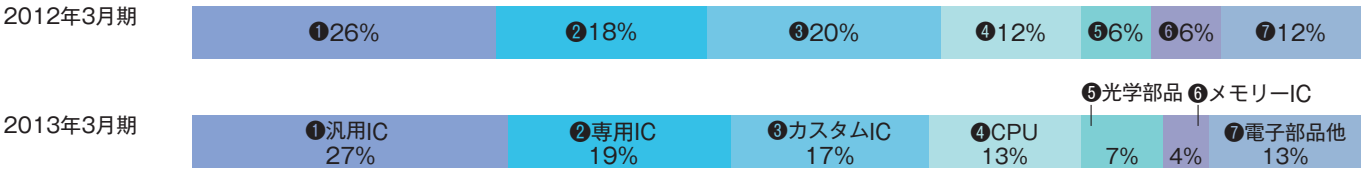


（注）2013年3月期より変更した新セグメントにて表記しております。

仕入先は有力半導体メーカ

最先端かつ世界シェアの高い半導体製品を中心に45社以上のメーカの商品を取り扱っております。

2013年3月期は、汎用IC（アナログ）、専用IC、CPU（DSP）が商権拡大を要因に前期より増加、カスタムICは産業機器向け販売低調により減少となりました。



主な商品		主な仕入先
①汎用IC 様々な用途に使用されるIC	アナログIC	リニアテクノロジー社、TI社
②専用IC 特定用途向けIC	画像補正用 DLP用 画像圧縮用	ピクセルワークス社、TI社 ビクシスシステムズ社
③カスタムIC お客様仕様に応じて作られるIC	PLD ASIC	ザイリンクス社 富士通セミコンダクター(株)
④CPU コンピュータの頭脳となるIC	マイクロプロセッサ DSP	フリースケール社 インテル社、TI社
⑤光学部品 電気を光に変換する電子部品	LED フォトカプラ	アバゴ・テクノロジー社
⑥メモリーIC 記憶用のIC	フラッシュメモリ SRAM	スパンション社 IDT社
⑦電子部品他 ボード製品、電源、ソフトウェアなど	評価ボード 電源 OS	インレビウム コーセル マイクロソフト社

仕入先紹介
 高性能アナログIC専門メーカ
 DSPやアナログICをはじめ 多種多様な製品を提供
 ALL PROGRAMMABLE. PLDのリーディングカンパニー
 車載・通信用ICで世界最大手
 ヒューレットパッカード社が前身の 光学部品パイオニアメーカ
 大手フラッシュメモリメーカ
 マイクロソフト社の 組み込み機器向けOS

高度な技術サポートと地域密着型できめ細やかなお客様対応

付加価値の高い商品を扱うことで必要となる技術サポートを提供する体制を整えております。

高度な技術サポートを提供

仕入先ごとに専属のエンジニア（FAE）を配置し、企画から製造まできめ細かい技術サポートを行っております。新製品の技術説明や技術的なお問い合わせ対応はもちろんのこと、不具合が起こった際には、スピーディーに対応いたします。

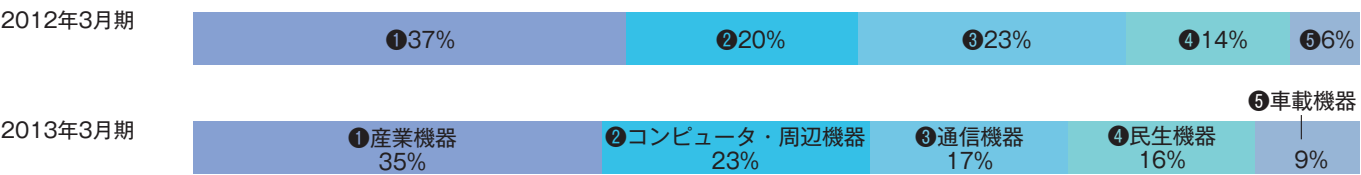
地域密着型営業できめ細やかなお客様対応

お客様の工場や生産拠点がある地域を中心に拠点を置き、商品のお問い合わせから、ご提案、開発・量産のサポートに対応しております。



幅広い用途向けに販売

2013年3月期は、産業機器は需要低迷により減少、コンピュータ・周辺機器は商権拡大により増加、通信機器はスマートフォン以外の機器において需要低調より減少、車載機器はマーケットが堅調であることに加え、商権拡大により増加となりました。



主な最終商品		主なお客様
①産業機器	 医療機器、放送機器、 半導体製造装置、 ロボット、計測器	沖電気、東芝、 パナソニック、日立
②コンピュータ・ 周辺機器	 複合プリンター、 PC及び付属機器、 プロジェクタ、POS端末	東芝、NEC、 パナソニック、 富士ゼロックス
③通信機器	 携帯電話、 スマートフォン、 伝送装置、基地局	NEC、パナソニック、 日立、富士通
④民生機器	 デジタルカメラ、 薄型TV、AV機器 DVD、白物家電	アルプス電気、ソニー、 東芝、パナソニック、 三菱電機
⑤車載機器	 カーナビゲーション、 カーオーディオ	アルプス電気、 パナソニック、日立、 三菱電機

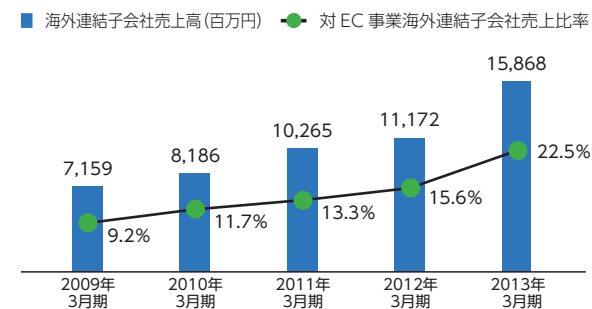
※主なお客様はグループ名で表記し、敬称を省略し、略称とさせていただきます。(五十音順)

海外向けの販売強化

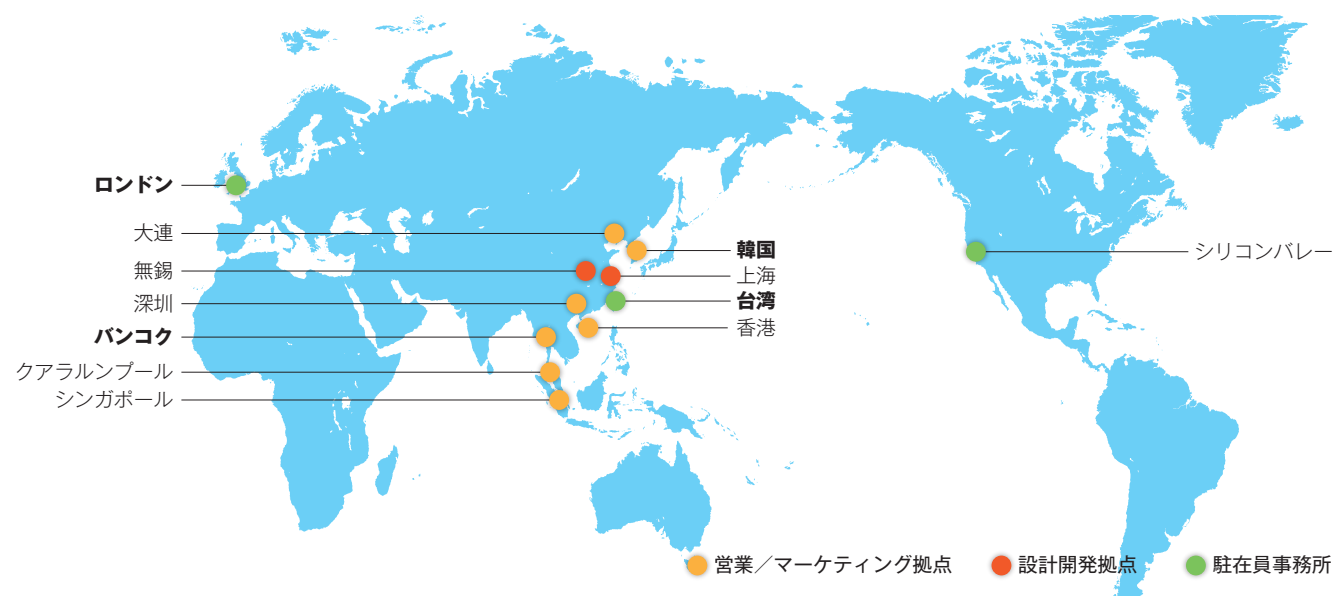
中国、アジア向けの販売を行う当社連結子会社のTED APACの売上高が158億6千8百万円(前期比42%増)となり、半導体及び電子デバイス事業の売上高706億4千1百万円に対する構成比が22.5%に達しました。

半導体及び電子デバイス事業の売上高に対して30%以上を目標に、現地企業への販路拡大などに取り組んでまいります。

海外連結子会社売上高



タイに販売拠点、韓国・台湾・イギリスに新商材発掘のためのマーケティング活動拠点を設置



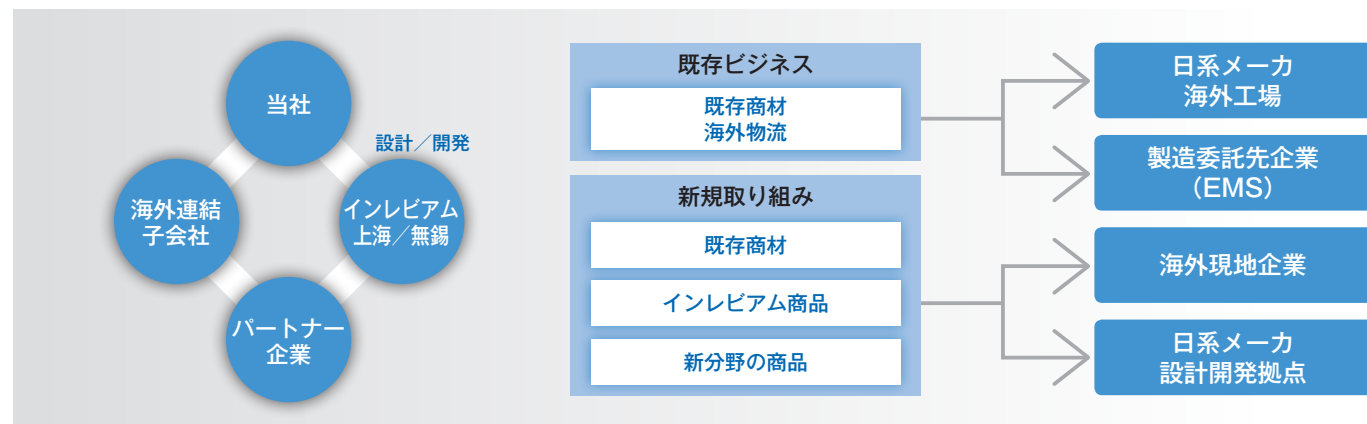
海外販売強化への取り組み

1. 海外現地企業向けの販売強化

これまで売上を伸ばしてきた日系メーカーの海外工場向けはもちろん、現地企業や日系メーカーの設計開発拠点に対しての販売に力を入れてまいります。

2. 現地の技術サポートに対応

上海と無錫の設計開発センターには、約70名の技術スタッフが在籍しており、商品の設計から開発までの技術サポートを海外でも提供できる体制があることは当社の強みになっております。

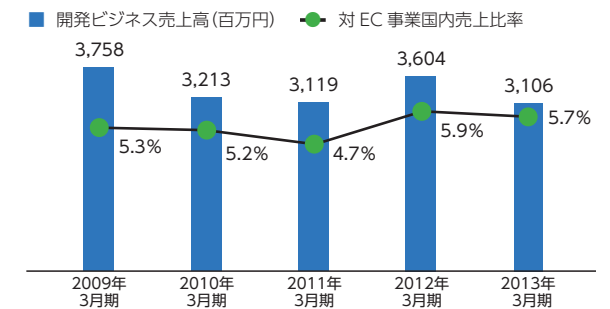


自社商品(インレビウム)の拡大

半導体ビジネスで培った技術サポートの経験を生かし、自社ブランド商品やデザインサービスを提供する開発ビジネスの売上高は31億6百万円(前期比14%減)となりました。

海外における自社ブランド「inrevium (インレビウム)」の販売促進と、新商材の開拓・販売に取り組んでまいります。

開発ビジネス売上高



日本・アジアに展開する設計開発センター

インレビウム商品を提供するための専門技術者を抱える設計開発センターを国内(横浜)とアジア(上海・無錫)に設置しています。設計開発センターでは、国内外で販売可能な自社ブランド商品の開発、半導体関連商品の設計を提供するデザインサービスを行っております。

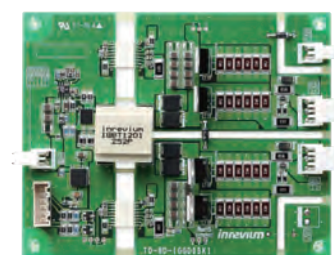


設計開発センター(横浜)

注力商品：IGBTゲートドライバ

IGBTには風力や太陽光などの再生可能エネルギーを効率的に制御する機能があり、当社はそのゲートドライブ部分の制御を容易に実現できるボード製品を開発しております。

現在は省エネ化への需要が高まっている中国市場を中心に販売促進活動を行っております。

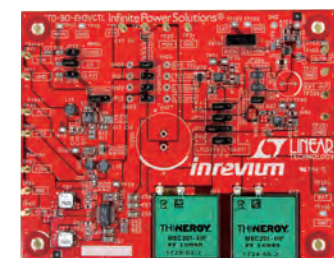


製品例：
光ファイバインタフェース搭載
IGBTゲートドライバ
[TD-BD-IGFB05K]

新事業への進出と新商流の構築

環境・省エネルギー分野への取り組み

環境・省エネルギー分野の新たな商品ラインアップの拡充に加え、お客様の開発支援にも注力しております。昨今、光・熱・振動など生活環境からのエネルギーを電気エネルギーに変換して再利用する環境発電が注目されております。この製品は、発電素子の特性やマイコン・センサーなどの初期検討を容易に行うことができます。



製品例：
リニアテクノロジー社製
環境発電IC搭載
環境発電アプリケーション
開発ボード
[TD-BD-EH3VCTL]

新商流の構築ーアジアから世界へー

当社は、これまでアメリカや日本のメーカーから、半導体やコンピュータシステム製品などの新規商品を発掘し、日系企業向けに販売するビジネスを中心に行ってまいりました。

今後は韓国や台湾をはじめとしたアジア地域で誕生している新規商材の開拓を進め、日本から海外に、アジアから世界へ発信し、新たな商流構築に取り組んでまいります。





事業紹介

コンピュータシステム関連事業

2013年3月期の業績

コンピュータ・ネットワーク機器の製品販売及び保守ビジネスがともに堅調な推移となったことから、売上高は148億3千5百万円（前期比2.2%増）、セグメント利益（経常利益）は前期に償却債権取立益を計上した反動減等により、11億3千8百万円（前期比20.7%減）となりました。

2014年3月期の見通しと活動方針

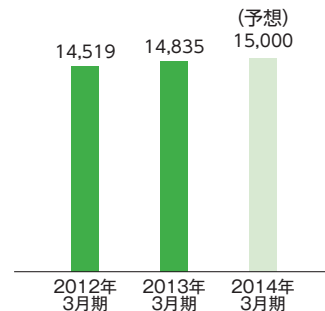
業績見込：売上高150億円（前期比1.1%増）

活動方針：クラウドサービスの普及に伴うデータセンタ拡大需要に注力

新素材やトータルソリューションの提案を推進

コンピュータシステム関連事業

■売上高（百万円）



（注）2013年3月期より変更した新セグメントにて表記しております。

専門性の高い商品を中心にラインアップ

新規性・専門性の高い商品を主力としています。2013年3月期は、ネットワーク関連機器、ミドルウェア他は直接販売の強化が奏功し増加、ストレージ関連機器は、国内企業向けが低調となりました。

2012年3月期	①55%	②38%	③7%
2013年3月期	①ネットワーク関連 58%	②ストレージ関連 33%	③ミドルウェア他 9%

主な商品		主な仕入先
①ネットワーク関連機器		
インターネットの接続負荷の分散、セキュリティ強化	負荷分散機器 ファイアウォール LANスイッチ	アリスタ・ネットワークス社 F5ネットワークス社 ジュニパー・ネットワークス社
②ストレージ関連機器		
大容量データの記憶、統合技術によるコスト削減	SANスイッチ ストレージ全般 フラッシュストレージ	ブロケード社 EMC社 フュージョン・アイオー社 ピュアストレージ社
③ミドルウェア他		
データベース管理、クラウドマネジメントシステム	データベース 仮想化ミドルウェア	バシヨー・テクノロジー社 オラクル社

仕入先紹介



1台で数万規模の同時アクセスを可能にする負荷分散装置メーカー



外部記憶装置のデータ処理を最適化するSANスイッチメーカー



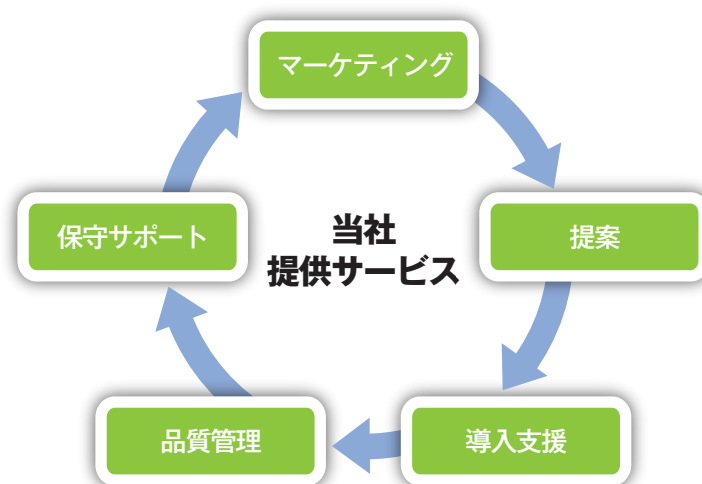
データウェアハウス、バックアップなどストレージ関連商品が豊富



データベース管理ソフトで世界シェアトップ

最先端商品のマーケティング、導入支援、保守サポート

アメリカのシリコンバレー地域に駐在員を置き、革新的かつ日本市場で需要が見込める商品をいち早く発掘、投入できる体制を整えています。また、新規性の高い商品の導入をスムーズにするための、検証体制・品質保証体制を整え、お客様に安心して導入いただけるサポート力が当社の強みとなっています。



品質管理

- ・受入検査
- ・出荷検査
- ・仕入先メーカーへフィードバック

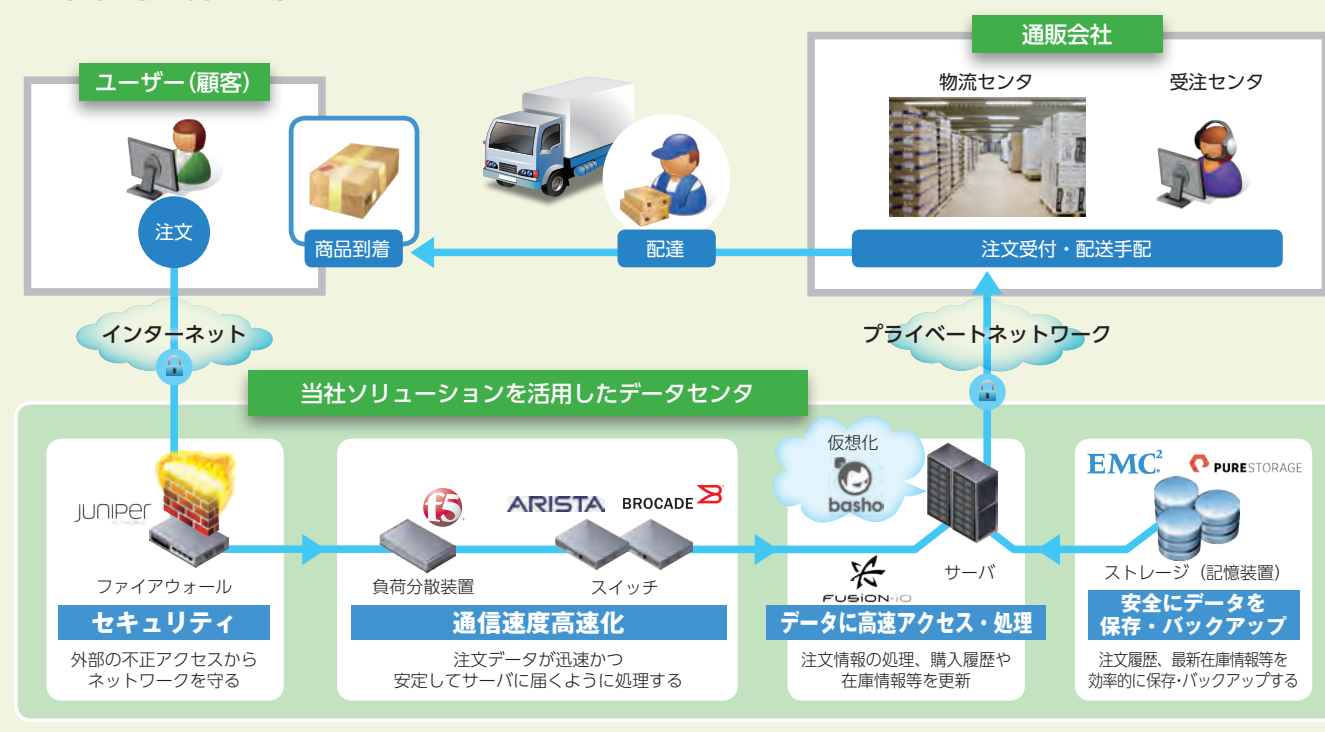
保守サポート

- ・製品保証
- ・代替機器先出し交換
- ・設置先訪問修理
- ・ワンストップ（一次切り分け対応）

お客様に最適なIT環境を提供

設備の入替コストの負担、カスタマイズが困難といった問題を解決する製品や、最先端技術でお客様に最適なIT環境をご提案します。

当社取り扱い商品活用イメージ



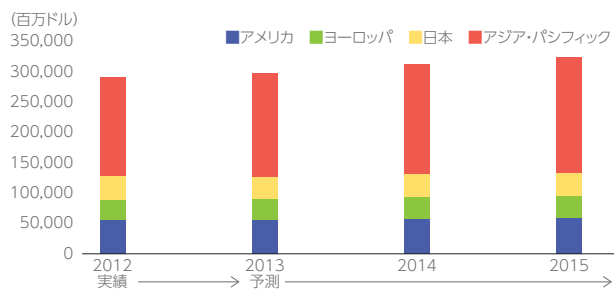
マーケット情報

半導体及び電子デバイス事業

世界の半導体市場予測

2012年の世界半導体市場は、世界経済の停滞やパソコンなどの販売不振により、ドルベースでの成長率が前年比2.7%減、市場規模は2,916億ドルとなりました。2013年は、世界全体では緩やかに回復するものの、世界の半導体の市場規模は対前年約62億ドル増の2,978億ドル（約27兆4,500億円）、前年比2.1%増と予測されています。2012年から2015年までの年平均成長率は3.7%となり、2015年には市場規模3,249億ドルとなるものと予測されています。

出所：WSTS「2013年 春季半導体市場予測」

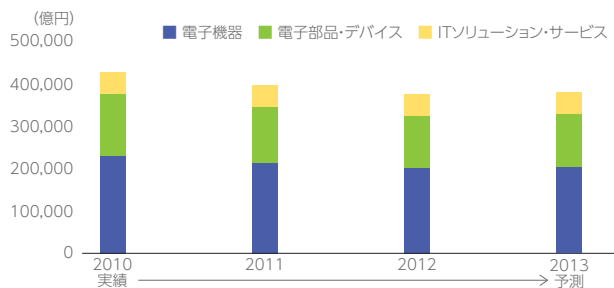


電子情報産業における日系企業の世界生産見通し

電子情報産業における2012年の日系企業生産額（海外生産分を含む）は、37兆4,871億円（対前年5%減）うち電子工業（※）で32兆4,367億円（同6%減）と2年連続のマイナスが見込まれています。2013年はキーデバイスを生かした製品進化に期待し、38兆1,061億円（同2%増）、うち電子工業32兆9,305億円（同2%増）の微増となる見通しです。

（※）電子工業：電子機器（AV機器・通信機器・コンピュータおよび情報端末）＋電子部品・デバイス

出所：JEITA「電子情報産業の世界生産見通し」



※電子機器＝AV機器、通信機器、コンピュータおよび情報端末

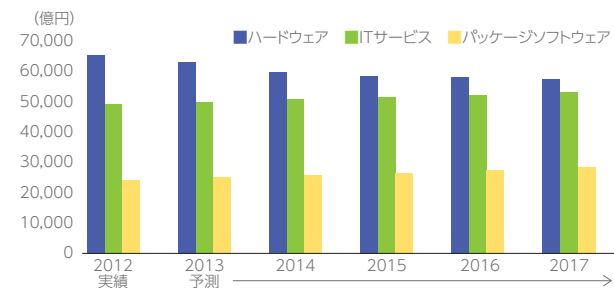
コンピュータシステム関連事業

国内製品別IT市場予測

2012年の国内IT市場規模は13兆7,962億円（前年比4.1%増）、製品別の市場規模は、国内ハードウェア市場6兆4,657億円（同6.2%増）、国内ITサービス市場4兆9,229億円（同1.6%増）、国内パッケージソフトウェア市場2兆4,075億円（同4.0%増）となりました。国内IT市場の2012～2017年の年間平均成長率は0.1%で、市場規模は2013年に13兆8,771億円、2017年には13兆9,525億円になるものと予測されています。

出所：IDC Japan ニュースリリース2013年1月31日/4月22日

「国内製品別IT市場予測を発表」

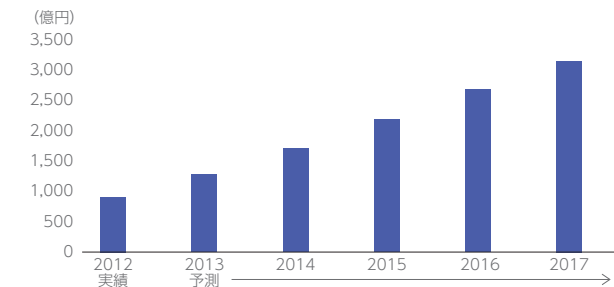


国内パブリッククラウドサービス市場予測

2012年の国内パブリッククラウドサービス市場規模は、前年比44.8%増の933億円となりました。2013年以降の国内パブリッククラウドサービス市場は、適用するシステム領域の多様化と、利用量の拡大が見込まれ、同市場は市場規模の拡大に伴い2012年の前年比成長率をピークに以後、成長率が低下していくものの高い成長が継続すると見られています。このため、2012年～2017年の年間平均成長率は27.8%、2017年の市場規模は2012年比3.4倍の3,178億円と予測 されています。

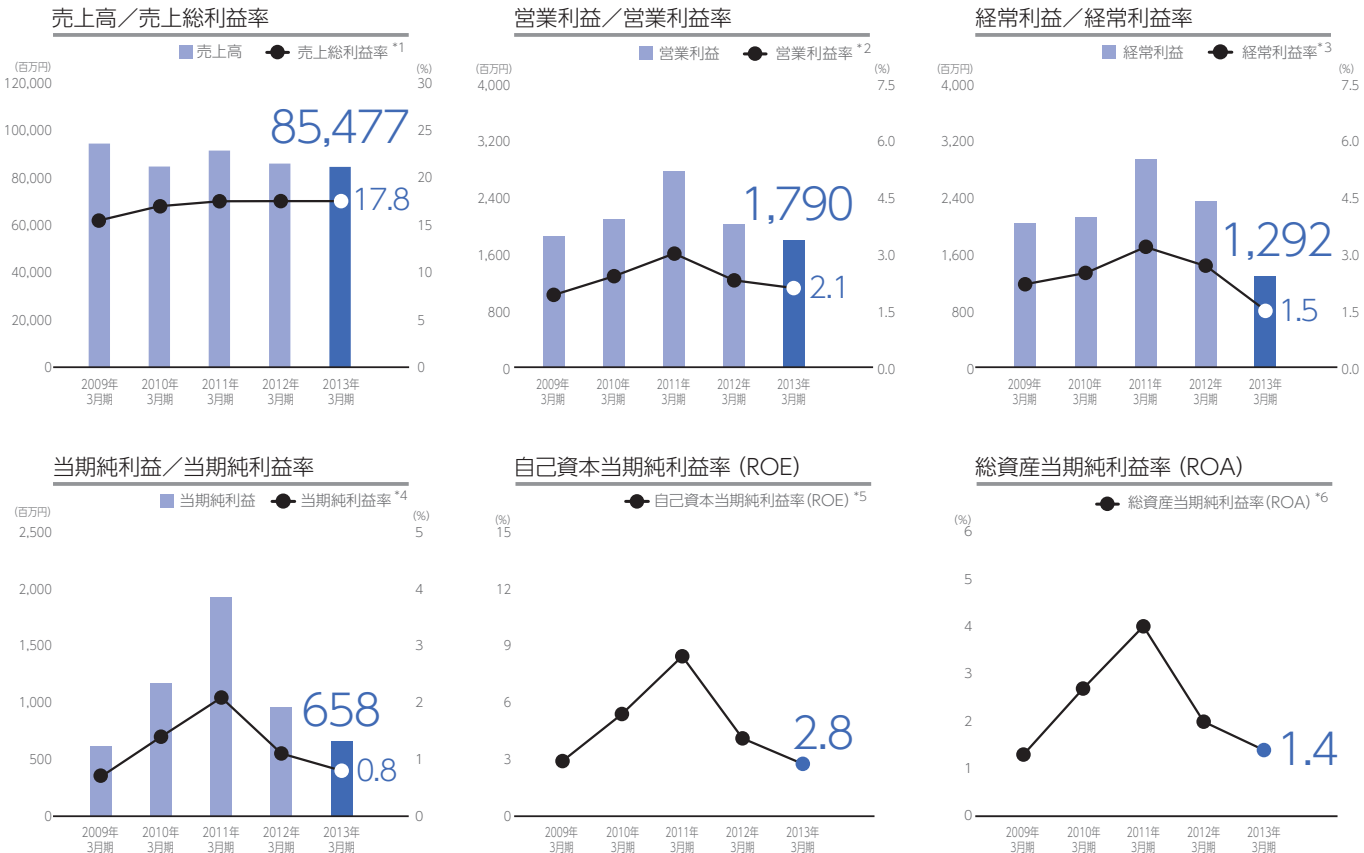
出所：IDC Japan ニュースリリース2013年4月1日

「国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表」



連結経営指標

収益性



	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
売上高 (百万円)	94,701	85,145	91,315	86,300	85,477
売上総利益率 (%) *1	15.5	17.0	17.7	17.8	17.8
営業利益 (百万円)	1,840	2,079	2,745	2,011	1,790
営業利益率 (%) *2	1.9	2.4	3.0	2.3	2.1
経常利益 (百万円)	2,041	2,117	2,941	2,332	1,292
経常利益率 (%) *3	2.2	2.5	3.2	2.7	1.5
当期純利益 (百万円)	617	1,166	1,918	960	658
当期純利益率 (%) *4	0.7	1.4	2.1	1.1	0.8
自己資本当期純利益率 (ROE : %) *5	2.9	5.4	8.5	4.1	2.8
総資産当期純利益率 (ROA : %) *6	1.3	2.7	4.0	2.0	1.4

*1. 売上総利益率＝売上総利益÷売上高

*2. 営業利益率＝営業利益÷売上高

*3. 経常利益率＝経常利益÷売上高

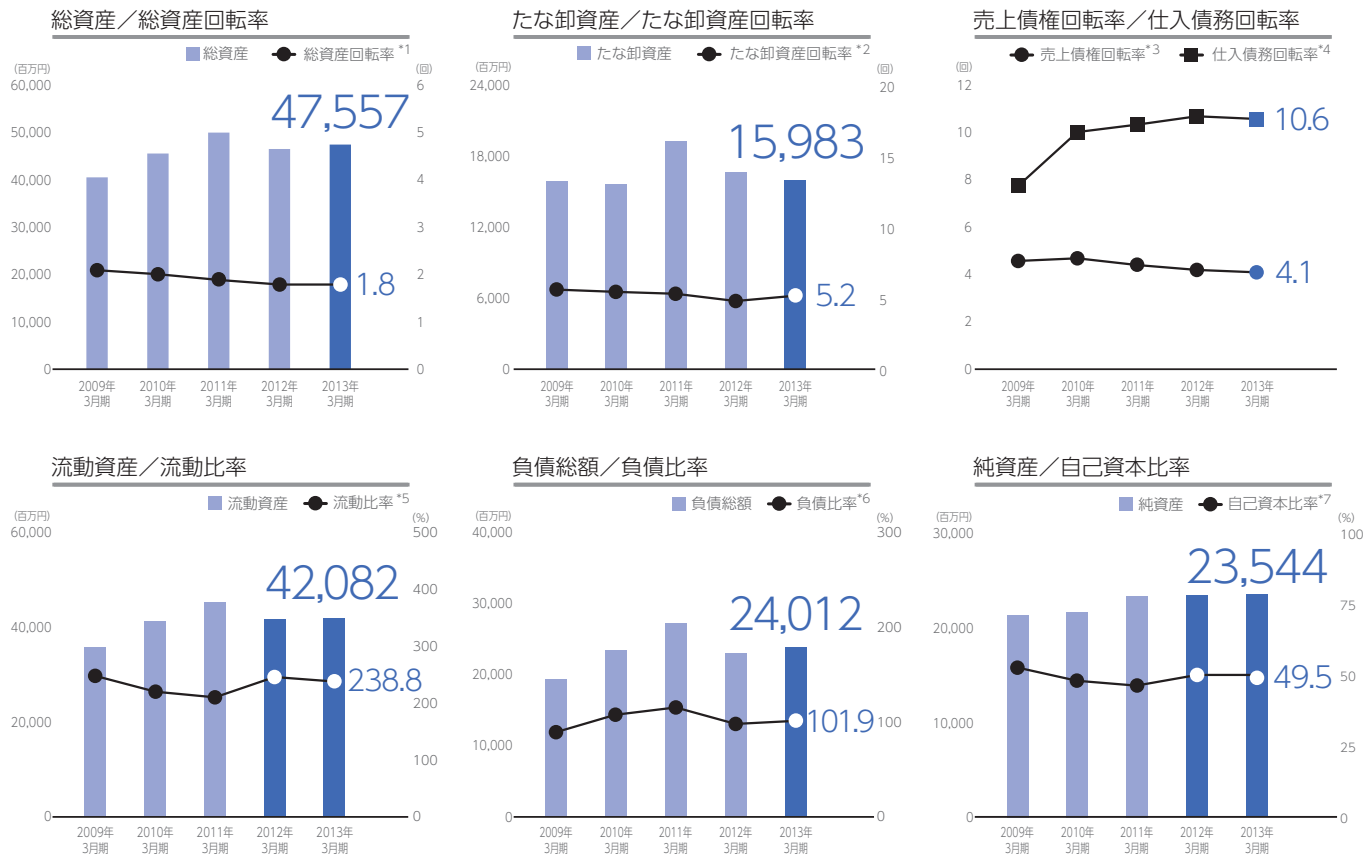
*4. 当期純利益率＝当期純利益÷売上高

*5. 自己資本当期純利益率（ROE）＝当期純利益÷期首・期末平均株主資本

*6. 総資産当期純利益率（ROA）＝当期純利益÷期首・期末平均総資産

連結経営指標

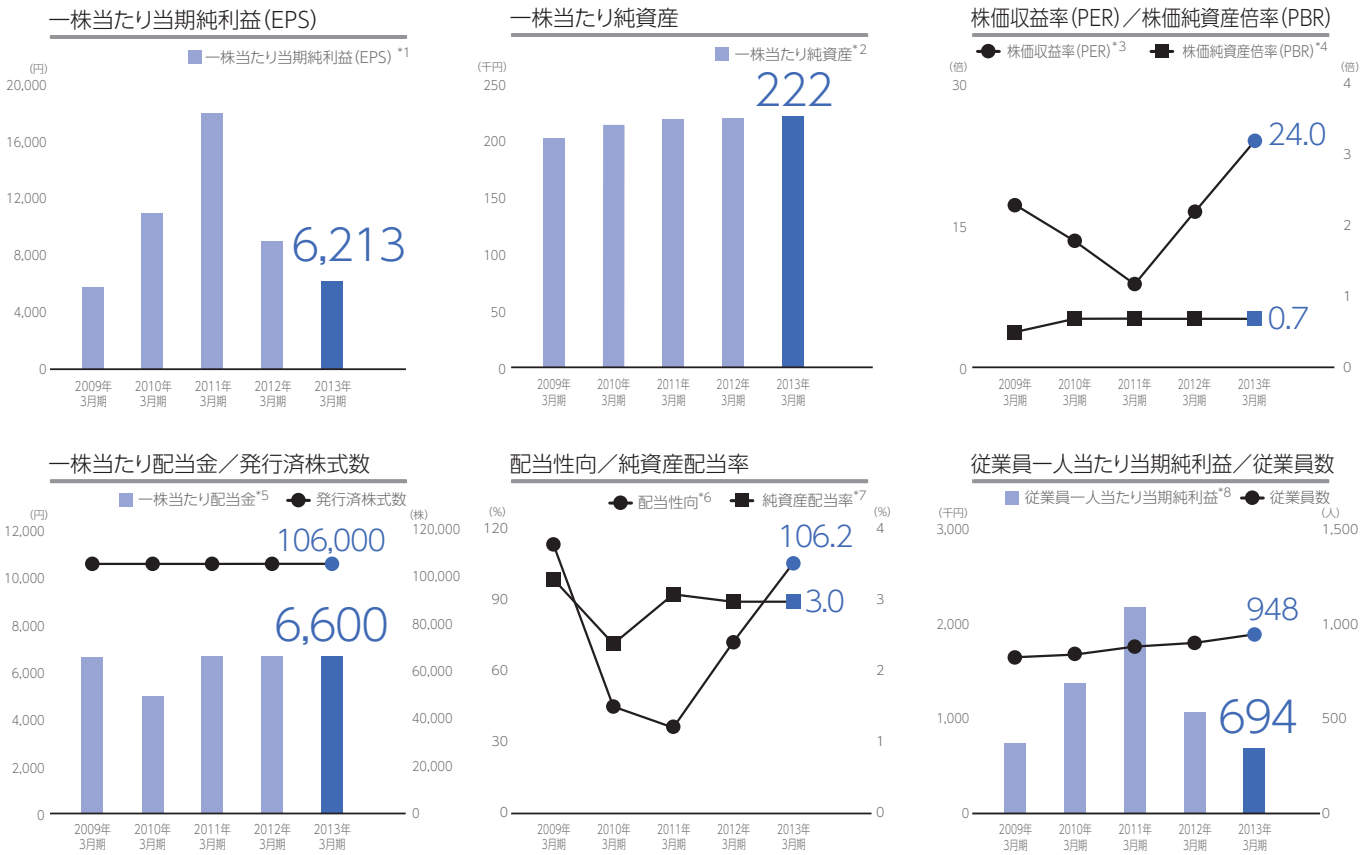
効率性・安全性



	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
総資産 (百万円)	40,680	45,649	50,254	46,391	47,557
総資産回転率 (回) ^{*1}	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8
たな卸資産 (百万円)	15,879	15,636	19,347	16,681	15,983
たな卸資産回転率 (回) ^{*2}	5.6	5.4	5.2	4.8	5.2
売上債権回転率 (回) ^{*3}	4.6	4.7	4.4	4.2	4.1
仕入債務回転率 (回) ^{*4}	7.8	10.1	10.3	10.7	10.6
流動資産 (百万円)	35,854	41,136	45,251	41,770	42,082
流動比率 (%) ^{*5}	247.6	221.9	212.6	247.4	238.8
負債総額 (百万円)	19,266	23,737	27,034	23,009	24,012
負債比率 (%) ^{*6}	89.6	107.7	115.6	97.5	101.9
純資産 (百万円)	21,413	21,911	23,220	23,381	23,544
自己資本比率 (%) ^{*7}	52.6	48.0	46.2	50.4	49.5

^{*1}. 総資産回転率＝売上高÷期首・期末平均総資産
^{*2}. たな卸資産回転率＝売上高÷期首・期末平均たな卸資産
^{*3}. 売上債権回転率＝売上高÷期首・期末平均（受取手形＋売掛金）
^{*4}. 仕入債務回転率＝売上原価÷期首・期末平均買掛金
^{*5}. 流動比率＝流動資産÷流動負債
^{*6}. 負債比率＝負債÷株主資本
^{*7}. 自己資本比率＝純資産÷総資産

その他の指標



	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
一株当たり当期純利益 (EPS：円) ^{*1}	5,824	11,000	18,095	9,064	6,213
一株当たり純資産 (千円) ^{*2}	202	206	219	220	222
株価収益率 (PER：倍) ^{*3}	17.2	13.4	8.8	16.5	24.0
株価純資産倍率 (PBR：倍) ^{*4}	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
一株当たり配当金 (円) ^{*5}	6,600	5,000	6,600	6,600	6,600
発行済株式数 (株)	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
配当性向 (%) ^{*6}	113.3	45.5	36.5	72.8	106.2
純資産配当率 (%) ^{*7}	3.3	2.4	3.1	3.0	3.0
従業員一人当たり当期純利益 (千円) ^{*8}	748	1,381	2,179	1,067	694
従業員数 (人)	825	844	880	900	948

^{*1}. 一株当たり当期純利益 (EPS) ＝当期純利益÷期中平均発行済株式数
^{*2}. 一株当たり純資産＝期末純資産÷期末発行済株式数
^{*3}. 株価収益率 (PER) ＝期末株価÷一株当たり当期純利益
^{*4}. 株価純資産倍率 (PBR) ＝期末株価÷一株当たり純資産
^{*5}. 一株当たり配当金＝支払済中間配当及び期末配当÷発行済株式数
^{*6}. 配当性向＝支払済中間配当及び期末配当÷当期純利益
^{*7}. 純資産配当率＝配当金総額÷期首・期末平均純資産
^{*8}. 従業員一人当たり当期純利益＝当期純利益÷期末従業員数

連結財務諸表

貸借対照表

(千円)

資産の部	2012年3月期 (2012年3月31日現在)	2013年3月期 (2013年3月31日現在)
流動資産	41,770,356	42,082,194
現金及び預金	1,264,865	1,141,308
受取手形及び売掛金	20,434,456	21,099,175
商品及び製品	16,590,132	15,897,241
仕掛品	90,930	86,489
繰延税金資産	746,673	613,167
その他	2,786,115	3,382,115
貸倒引当金	△ 142,817	△ 137,302
固定資産	4,620,752	5,474,814
有形固定資産	1,254,463	1,131,092
建物及び構築物（純額）	939,025	832,414
工具、器具及び備品（純額）	303,922	251,753
リース資産（純額）	9,842	6,104
建設仮勘定	1,673	40,820
無形固定資産	429,324	988,731
投資その他の資産	2,936,963	3,354,990
投資有価証券	18,000	370,687
繰延税金資産	1,915,180	2,010,328
その他	1,013,261	984,124
貸倒引当金	△ 9,478	△ 10,150
① 資産合計	46,391,108	47,557,009

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

① 資産

総資産は 475 億 5 千 7 百万円となり、前期末に比べ 11 億 6 千 5 百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、のれんが増加したことによります。

(千円)

負債の部	2012年3月期 (2012年3月31日現在)	2013年3月期 (2012年3月31日現在)
流動負債	16,886,131	17,622,285
買掛金	5,915,821	7,325,337
短期借入金	4,402,726	3,756,240
未払法人税等	606,311	486,254
前受金	2,932,667	3,352,335
賞与引当金	841,663	679,326
役員賞与引当金	41,526	24,840
その他	2,145,414	1,997,950
固定負債	6,122,986	6,390,153
退職給付引当金	5,487,908	5,746,406
役員退職慰労引当金	155,022	163,729
その他	480,055	480,017
② 負債合計	23,009,117	24,012,438
純資産の部		
株主資本	23,608,772	23,567,808
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	15,467,781	15,426,817
その他の包括利益累計額	△ 226,781	△ 23,237
その他有価証券評価差額金	—	28,810
繰延ヘッジ損益	△ 96,639	△ 53,937
為替換算調整勘定	△ 130,141	1,889
③ 純資産合計	23,381,990	23,544,570
負債純資産合計	46,391,108	47,557,009

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

② 負債

負債総額は 240 億 1 千 2 百万円となり、前期末に比べ 10 億 3 百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が減少した一方、買掛金、前受金が増加したことによります。

③ 純資産

純資産総額は 235 億 4 千 4 百万円となり、前期末に比べ 1 億 6 千 2 百万円の増加となりました。

損益計算書

(千円)

科目	2012年3月期 2011年4月 1 日から 2012年3月31日まで	2013年3月期 2012年4月 1 日から 2013年3月31日まで
売上高	86,300,226	85,477,675
売上原価	70,945,877	70,236,257
売上総利益	15,354,348	15,241,418
販売費及び一般管理費	13,342,860	13,450,989
給料及び手当	5,105,420	5,469,038
賞与引当金繰入額	819,957	667,842
退職給付引当金繰入額	784,371	789,561
その他	6,633,111	6,524,547
営業利益	2,011,488	1,790,428
営業外収益	393,675	52,534
受取配当金	4,608	—
セミナー開催収入	7,253	15,218
保険配当金	37,296	13,440
為替差益	84,620	—
投資有価証券精算益	4,235	11,485
償却債権取立益	216,130	—
その他	39,530	12,390
営業外費用	72,166	550,066
為替差損	—	486,681
その他	72,166	63,384
経常利益	2,332,997	1,292,896
特別利益	—	22
固定資産売却益	—	22
特別損失	21,514	9,543
固定資産売却損	51	—
固定資産除却損	11,113	8,682
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	—	861
ゴルフ会員権評価損	10,349	—
税金等調整前当期純利益	2,311,483	1,283,375
法人税、住民税及び事業税	1,129,549	628,593
法人税等調整額	221,109	△ 3,854
少数株主損益調整前当期純利益	960,823	658,636
当期純利益	960,823	658,636

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

包括利益計算書

(千円)

科目	2012年3月期 2011年4月 1 日から 2012年3月31日まで	2013年3月期 2012年4月 1 日から 2013年3月31日まで
少数株主損益調整前当期純利益	960,823	658,636
その他の包括利益	△ 68,163	203,543
その他有価証券評価差額金	—	28,810
繰延ヘッジ損益	△ 66,980	42,702
為替換算調整勘定	△ 1,182	132,030
包括利益	892,660	862,180
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	892,660	862,180
少数株主に係る包括利益	—	—

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

キャッシュ・フロー計算書

(千円)

科目	2012年3月期 2011年4月 1 日から 2012年3月31日まで	2013年3月期 2012年4月 1 日から 2013年3月31日まで
④ 営業活動によるキャッシュ・フロー	4,602,738	3,375,952
⑤ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 383,783	△ 1,919,449
⑥ 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,330,218	△ 1,587,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,889	7,031
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 108,374	△ 123,556
現金及び現金同等物の期首残高	1,373,240	1,264,865
現金及び現金同等物の期末残高	1,264,865	1,141,308

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は 33 億 7 千 5 百万円 (前年同期は 46 億 2 百万円の収入) となりました。これは主に、たな卸資産の減少、仕入債務の増加等の資金増加要因によるものです。

⑤ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、19 億 1 千 9 百万円 (前年同期は 3 億 8 千 3 百万円の使用) となりました。これは主に、事業譲受による支払い、ソフトウェアの取得による支払い及び投資有価証券の取得による支払いによるものです。

⑥ 財務活動によるキャッシュ・フロー

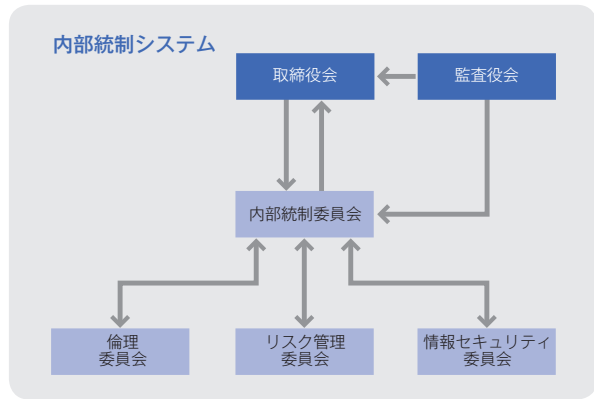
財務活動の結果使用した資金は 15 億 8 千 7 百万円 (前年同期は 43 億 3 千万円の使用) となりました。これは主に、短期借入金の返済及び配当金の支払いによるものです。

会社概要／株式情報

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主各位及びステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先に考えております。当社の内部統制システムは、内部統制システム全体の整備と運用を推進する内部統制委員会のもと、倫理委員会がコンプライアンス体制を、リスク管理委員会がリスク管理体制を、情報セキュリティ委員会が情報の保存及び管理体制を推進しております。

なお、監査役会は、取締役会に対し、内部統制に関する提言を行い、内部統制委員会の監視も行っております。



事業等のリスク

1. 業績の変動要因について

当社グループでは、半導体製品、ボード製品、一般電子部品、ネットワーク機器、ストレージ機器、ミドルウェア、ソフトウェア等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品を主に取り扱っております。半導体及び電子デバイス事業では、得意先が大手エレクトロニクスメーカ等であることから、半導体需要や設備投資動向に影響を受ける可能性があります。コンピュータシステム関連事業では、顧客がネットワークやシステムの構築・整備に関連した企業や団体等であることから、IT投資等の設備投資に係る動向に影響を受ける可能性があります。当社グループでは従来より、付加価値が高く、価格変動が比較的少ない商品の取り扱いを増やすことなどを通じ、これらの影響を回避する方策を採っておりますが、取引相手先を含めたエレクトロニクス業界全体の需給バランスが悪化することにより、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

2. 為替変動の影響について

当社グループは、エレクトロニクス商品の輸出入取引を行っており、また、一部の国内顧客との間において外貨建取引を行っております。取引発生時と決済時の為替変動リスクに関しては、為替予約によってリスク回避に努めております。また、為替変動による仕入価格の変動に関しては、仕入価格の動向を勘案して販売価格を改定する等の方策を採っておりますが、急激な為替変動は当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

3. 仕入先の依存度について

当社グループの主要な仕入先は、日本テキサス・インスツルメンツ株式会社、リニアテクノロジー社であり、2013年3月期における当社グループの総仕入実績に対する割合はそれぞれ15.8%、10.1%となっております。各社とは取引基本契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移してきましたが、このような取引関係が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の動向によっては、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

4. 親会社等との関係について

当社グループは、当社の親会社である東京エレクトロン株式会社（持株比率55.4%）を中核とした東京エレクトロングループ（以下「グループ」といいます。）の一員であり、半導体電子部品及びコンピュータ・ネットワーク部門を担っております。グループはその他、半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル）製造装置の製造子会社並びにグループ内のサービス子会社で構成されており、グループ内で事業の棲み分けが図られているため、当社グループと競合関係にある会社はありません。なお、2013年3月期における当社グループとグループ会社との取引関係、人的関係等は次のとおりであります。しかしながら、当社グループとグループ会社との取引関係、人的関係の安定性は保証されているわけではありません。

A. 営業取引

単位：千円	親会社	親会社以外のグループ会社
売上高	9,658	803,709
仕入高	2,296	37,411
販売費及び一般管理費	40,014	420,624

B. 親会社からの役員受入

半導体業界に幅広い人的ネットワークと見識を兼ね備えた親会社の人材を受け入れることは、当社経営の一助となると考えております。なお、日常の経営意思決定並びに業務執行については、当社常勤役員により行われておりますので、経営の独立性は確立していると考えております。親会社の役員等による兼任状況は次のとおりであります。

(2013年7月1日現在)

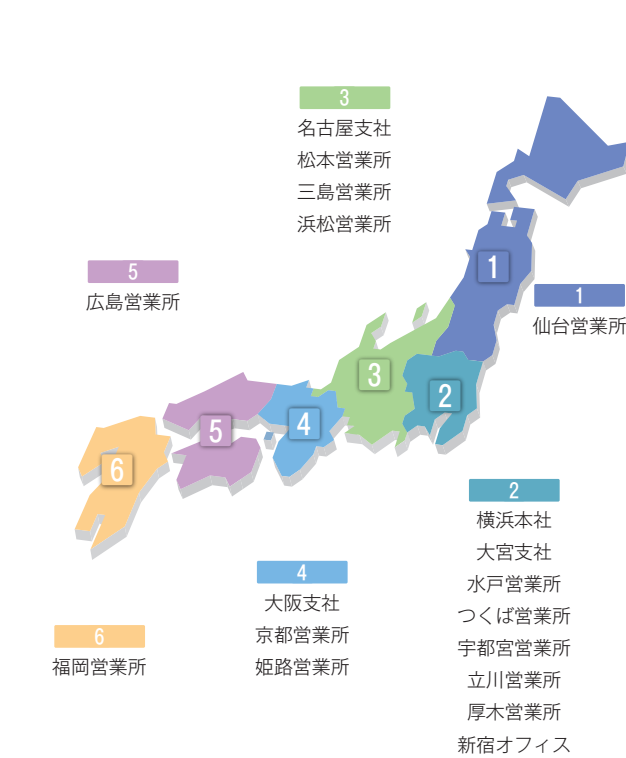
氏名	当社役職	親会社役職
常石 哲男	取締役（非常勤）	取締役副会長

会社の概要（2013年3月31日現在）

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社
設立	1986年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	948名（連結）
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア



拠点（2013年7月1日現在）



グループ会社

パネトロン株式会社
 東電電子零件亞太區有限公司(TED APAC)
 上海華桑電子零件貿易有限公司(TED上海)
 Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd.
 上海華桑電子有限公司(インレビウム上海)
 無錫華桑電子科技有限公司(インレビウム無錫)

役員等（2013年6月18日現在）

取締役		執行役員
取締役会長	砂川 俊昭	栗木 康幸
代表取締役社長	栗木 康幸	久我 宣之
代表取締役副社長	久我 宣之	天野 勝之
取締役	天野 勝之	穴倉 弘明
取締役	徳重 敦之	徳重 敦之
取締役	初見 泰男	初見 泰男
取締役	上小川 昭浩	上小川 昭浩
取締役(非常勤)	常石 哲男	八幡 浩司
社外取締役	石川 國雄	黒田 修治
		林 英樹
		石崎 敏之
		根岸 雄二
		高木 信彦
		浅野 升徳
		上善 良直

株式情報（2013年3月31日現在）

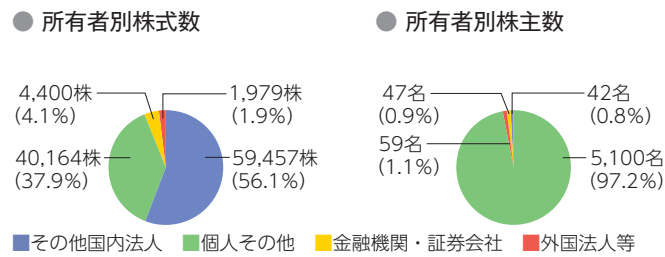
株式の状況

発行可能株式総数	256,000株
発行済株式の総数	106,000株
株主数	5,248名

大株主

株主名	持株数(株)	出資比率(%)
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.4
東京エレクトロンデバイス社員持株会	4,909	4.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	627	0.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	553	0.5
日本証券金融株式会社	508	0.5

株式分布状況



株価と出来高

